



グローバル企業・外資×ハイクラス転職

「語学力」を活かす転職なら、JAC Recruitment

半導体デバイスの製品企画・開発

大手電機メーカーでの募集です。商品企画・商品開発（技術系）のご経験のある方は...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

大手電機メーカー

求人ID

1468001

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

大阪府

給与

550万円～900万円

勤務時間

08:30～17:00

休日・休暇

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 GW 夏季...

更新日

2024年04月26日 16:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

日常会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

専門学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2134918】

■担当業務と役割

次世代製品の調査・企画・構想・開発を担う部署のメンバーとして活躍頂きます。社内外の技術開発連携、調査および活用も視野に技術ノウハウの蓄積と技術検証、技術の製造拠点への移管を行っていただきます。当社既存の半導体リレー進化させた次世代製品、強みを活かした新機軸製品など、独自・革新的なアイデアを提案すること、アイデアを具現化していくことが期待されます。

■具体的な仕事内容

- ・関連部署（営業、品質、製造）を巻き込み新たな発想で次世代製品の企画推進
 - ・市場トレンドをふまえ、革新的な新製品企画、実現のための要素開発課題を明確化し技術検証
 - ・構想したアイデアのフィジビリティスタディを自律して主体的に推進
 - ・例えば、高耐圧、大電流化のための半導体リレー構造設計（パッケージ構造、フレーム構造）、半導体素子の要素開発など
-

スキル・資格

■必須要件 ・半導体関連のデバイス開発・設計の経験 ３年以上 ・半導体プロセスに関する知識（チップ実装、パッケージ構造、素子一般） ■歓迎要件 ・高周波回路設計もしくは半導体回路設計の経験 ・解析スキル（構造・熱・流体） ・半導体デバイスの評価技術 ・TOEIC 550点以上

会社説明

ご紹介時にご案内いたします